

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有  
限公司、成都士兰半导体制造有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集  
昕”、“成都士兰”）。士兰集成、士兰集昕和成都士兰均为本公司之控股子  
公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 11 月 1 日至 2023  
年 11 月 30 日，公司在年度预计担保金额内为士兰集成提供担保金额 0.2 亿元，  
为士兰集昕提供担保金额 0.3 亿元；公司为控股子公司成都士兰项目贷款签署了  
担保金额为 5 亿元的担保合同，实际提供的担保余额为 1 亿元。

截至 2023 年 11 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 6.12 亿元，  
公司为士兰集昕实际提供的担保余额为 10.41 亿元，公司为成都士兰实际提供的  
担保余额为 3.78 亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 本次担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计担保进展情况

2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司在年度预计担保金额内实际  
发生的担保如下：

| 担保合同<br>名称  | 担保合同<br>签署日期       | 保证人                   | 被担保人                 | 债权人                    | 担保金额                           | 担保方式         |
|-------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| 不可撤销<br>担保书 | 2023 年 11<br>月 6 日 | 杭州士兰微<br>电子股份有<br>限公司 | 杭州士兰集<br>成电路有限<br>公司 | 招商银行股<br>份有限公司<br>杭州分行 | 担保的债权额为人民币 0.08 亿元及其<br>利息、费用等 | 连带责任<br>保证担保 |
| 不可撤销<br>担保书 | 2023 年 11<br>月 6 日 | 杭州士兰微<br>电子股份有<br>限公司 | 杭州士兰集<br>成电路有限<br>公司 | 招商银行股<br>份有限公司<br>杭州分行 | 担保的债权额为人民币 0.12 亿元及其<br>利息、费用等 | 连带责任<br>保证担保 |

|         |            |               |                 |                |                         |          |
|---------|------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|
| 不可撤销担保书 | 2023年11月6日 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州士兰集昕微电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 担保的债权额为人民币0.3亿元及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 |
|---------|------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------|

## （二）专项担保进展情况

2023年11月1日至2023年11月30日，公司专项担保进展如下：

| 担保合同名称 | 担保合同签署日期   | 保证人           | 被担保人          | 债权人         | 担保金额                     | 担保方式     |
|--------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------|----------|
| 保证合同   | 2023年11月7日 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 成都士兰半导体制造有限公司 | 国家开发银行四川省分行 | 担保的债权额为人民币5.00亿元及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 |

## （三）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于本公司2023年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，同意公司在2023年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过32亿元，其中对士兰集成提供日常担保不超过8亿元、对士兰集昕提供日常担保不超过13亿元、对成都士兰和成都集佳提供日常担保合计不超过6亿元（成都士兰和成都集佳可以在此担保总额内，根据各自对资金的实际需求，切分担保额度）。以上担保预计金额包含以前年度延续至2023年度的日常担保余额，且在2023年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上日常担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2023年3月31日和2023年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，公告编号为临2023-015、临2023-021和临2023-029。

公司于2023年8月17日召开的第八届董事会第九次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》，同意公司对成都士兰5亿元项目贷款提供担保（该笔担保不在上述日常担保额度范围内）。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2023年8月19日和2023年9月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，公告编号为临2023-044、临2023-047和临2023-051。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

（四）截至 2023 年 11 月 30 日：

（1）公司为士兰集成提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 6.12 亿元，剩余可用担保额度为 1.88 亿元；公司为士兰集昕提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 10.41 亿元，剩余可用担保额度为 2.59 亿元；公司为成都士兰实际提供的日常担保余额为 2.78 亿元，公司为成都集佳实际提供的日常担保余额为 1.87 亿元，成都士兰和成都集佳合计剩余可用日常担保额度为 1.35 亿元；担保余额均在公司 2022 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

（2）公司为成都士兰 5 亿元项目贷款提供担保事项，实际提供的担保余额为 1 亿元，剩余可用额度为 4 亿元。担保余额在公司 2023 年第二次临时股东大会批准的担保额度范围内。

## 二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本情况如下：

| 公司名称              | 统一社会信用代码           | 成立时间             | 注册地  | 法定代表人 | 注册资本<br>(万元) | 本公司持股比例 (%) |       | 主营业务          |
|-------------------|--------------------|------------------|------|-------|--------------|-------------|-------|---------------|
|                   |                    |                  |      |       |              | 直接          | 间接    |               |
| 杭州士兰集成电路有限公司      | 913301017265863549 | 2001 年 1 月 12 日  | 浙江杭州 | 陈向东   | 60,000       | 98.75       |       | 芯片制造          |
| 杭州士兰集昕微电子有<br>限公司 | 91330101MA27W6YC2A | 2015 年 11 月 4 日  | 浙江杭州 | 陈向东   | 224,832.8735 | 36.00       | 32.35 | 芯片制造          |
| 成都士兰半导体制造有<br>限公司 | 91510121564470905W | 2010 年 11 月 18 日 | 四川成都 | 陈向东   | 316,969.70   | 54.05       |       | 硅外延制造；芯片和模块封装 |

（二）被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

| 项 目  | 2023年9月末/2023年1-9月<br>(未经审计) | 2022年末/2022年度<br>(经审计) |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 198,191                      | 197,515                |
| 负债总额 | 99,784                       | 96,847                 |
| 净资产  | 98,407                       | 100,668                |

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| 营业收入 | 104,658 | 155,478 |
| 净利润  | -2,596  | -1,460  |

被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下：

（单位：人民币 万元）

| 项 目  | 2023年9月末/2023年1-9月<br>（未经审计） | 2022年末/2022年度<br>（经审计） |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 372,419                      | 364,698                |
| 负债总额 | 162,496                      | 155,402                |
| 净资产  | 209,923                      | 209,296                |
| 营业收入 | 105,350                      | 131,345                |
| 净利润  | 448                          | -1,720                 |

被担保人成都士兰最近一年及一期的主要财务数据（合并报表口径）如下：

（单位：人民币 万元）

| 项 目  | 2023年9月末/2023年1-9月<br>（未经审计） | 2022年末/2022年度<br>（经审计） |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 340,608                      | 269,591                |
| 负债总额 | 133,933                      | 135,584                |
| 净资产  | 206,675                      | 134,007                |
| 营业收入 | 120,107                      | 127,633                |
| 净利润  | 1,599                        | 4,258                  |

（三）士兰集成、士兰集昕、成都士兰均为本公司的控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

| 担保合同名称  | 保证人           | 被担保人          | 债权人            | 担保金额                        | 担保方式     | 担保期限                             |
|---------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|
| 不可撤销担保书 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州士兰集成电路有限公司  | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 担保的债权额为人民币 0.08 亿元 及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 | 自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年 |
| 不可撤销担保书 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州士兰集成电路有限公司  | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 担保的债权额为人民币 0.12 亿元 及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 | 自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年 |
| 不可撤销担保书 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 杭州士兰集昕微电子有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 担保的债权额为人民币 0.3 亿元 及其利息、费用等  | 连带责任保证担保 | 自本担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年 |

|      |               |               |             |                            |          |                    |
|------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|----------|--------------------|
| 保证合同 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 成都士兰半导体制造有限公司 | 国家开发银行四川省分行 | 担保的债权额为人民币 5.00 亿元及其利息、费用等 | 连带责任保证担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 |
|------|---------------|---------------|-------------|----------------------------|----------|--------------------|

上述担保均无反担保。上述担保均非关联担保。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足控股子公司士兰集成、士兰集昕和成都士兰日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人士兰集成、士兰集昕和成都士兰为公司合并报表范围内的子公司，具备良好的偿债能力，风险可控。

#### 五、董事会意见

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；公司独立董事就该担保事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，公告编号为临 2023-015、临 2023-021 和临 2023-029。

公司于 2023 年 8 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司成都士兰提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日和 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告，公告编号为临 2023-044、临 2023-047 和临 2023-051。

#### 六、累计对外担保数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 51.566 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 69.94%。公司对控股子公司提供的担保总额为 39.13 亿元、控股子公司之间提供的担保总额为 1.37 亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的 54.93%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 8.216 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 11.14%；公司为厦门士兰明镓化合物半导体有限公司提供的担保总额为 2.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.87%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批

准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。)

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日